

УДК 621.03  
ББК 34.6+222  
Ф50

Авторы:

В. С. Кушнер, О. Ю. Бургонова, А. А. Крутько, А. М. Ласица

Рецензенты:

В. В. Акимов, д.т.н., профессор кафедры «Автомобили,  
конструкционные материалы и технологии» ФГБОУ ВО «СибАДИ»;

И. И. Малахов, к.т.н., доцент кафедры «Специальные технические дисциплины»  
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»

**Физические основы технологических процессов** [Электронный ресурс] : учеб.  
пособие / В. С. Кушнер, О. Ю. Бургонова, А. А. Крутько, А. М. Ласица ; Минобрнауки  
России, ОмГТУ. – Электрон. текст. дан. (2,50 Мб). – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2020. –  
1 электрон. опт. диск. – Минимальные системные требования: процессор Intel Pentium  
1,3 ГГц и выше; оперативная память 256 Мб и более; свободное место на жестком диске  
260 Мб и более; операционная система Microsoft Windows XP/Vista/7/10; разрешение  
экрана 1024×768 и выше; акустическая система не требуется; дополнительные про-  
граммные средства Adobe Acrobat Reader 5.0 и выше. – ISBN 978-5-8149-3142-9.

Приведены краткие сведения из теории теплопроводности о распространении  
теплоты при различных граничных условиях, методы расчета некоторых физических  
величин, полученных от различных источников теплоты, а также примеры приме-  
нения этих методов к анализу тепловых процессов при различных методах обработки  
материалов: при литье, давлении, сварке, резании. Рассмотрен термомеханический  
метод расчета температур, характеристик сопротивления материалов пластическим  
деформациям, плотностей тепловых потоков, основанный на учете взаимосвязи этих  
факторов.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям  
15.03.01, 22.03.01 и 15.05.01.

Редактор *К. В. Обухова*

Компьютерная верстка *О. Г. Белименко*

*Для дизайна этикетки использованы материалы  
из открытых интернет-источников*

---

Сводный темплан 2020 г.

© ОмГТУ, 2020

Подписано к использованию 03.10.20.

Объем 2,50 Мб.